



PANEL THERMOCHIP

PANEL THERMOCHIP	e total (mm)	RT (m2K/W)	U (W/m2K)	Peso (kg/m2)	Peso (kg/panel)	*3 apoyos L=1220	
						Carga max. (kg/m2)	Carga a L=200 (kg/m2)
TPLH/13-40-19_XPS 40mm	72	1,41	0,71	21,58	31,59	907,00	231,00
TPLH/13-50-19_XPS 50mm	82	1,71	0,58	21,90	32,06	1042,00	263,00
TPLH/13-60-19_XPS 60mm	92	1,91	0,52	22,22	32,53	1140,00	306,00
TPLH/13-80-19_XPS 80mm	112	2,48	0,40	22,86	33,47	1435,00	385,00
TPLH/13-100-19_XPS 100mm	132	2,90	0,34	23,50	34,40	1743,00	444,00
TPLH/13-120-19_XPS 120mm	152	3,62	0,28	24,14	35,34	1882,00	480,00
TPLH/13-140-19_XPS 140mm	172	4,20	0,24	24,78	36,28	1972,00	515,00
TPLH/13-160-19_XPS 160mm	192	4,77	0,21	25,42	37,21	>1972,00	>515,00
TPLH/13-200-19_XPS 200mm	234	5,60	0,18	26,70	39,09	>1972,00	>515,00

*Resistencia mecánica, cargas positivas en apoyos. L en mm

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

Tablero exterior - Aglomerado hidrófugo

Espesor	e (mm)	19
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,13
Densidad	D (kg/m3)	600
Difusión al vapor de agua	μ	20
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1700

Núcleo aislante - XPS

Espesor	e (mm)	40	50	60	80	100	120	140	160	200
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,033	0,033	0,035	0,035	0,037	0,035	0,035	0,035	0,037
Densidad	D (kg/m3)	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Difusión al vapor de agua	μ	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1.450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450

Tablero interior - Placa de Yeso Laminado

Espesor	e (mm)	12,5
Conductividad térmica	λD (W/(m·K))	0,25
Densidad	D (kg/m3)	712
Difusión al vapor de agua	μ	10
Calor específico	Ce [J/(kg·K)]	1000